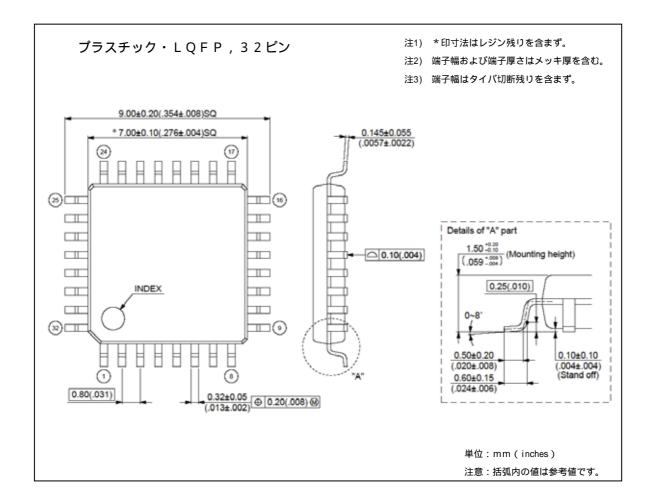
パッケージ

[RPG100]

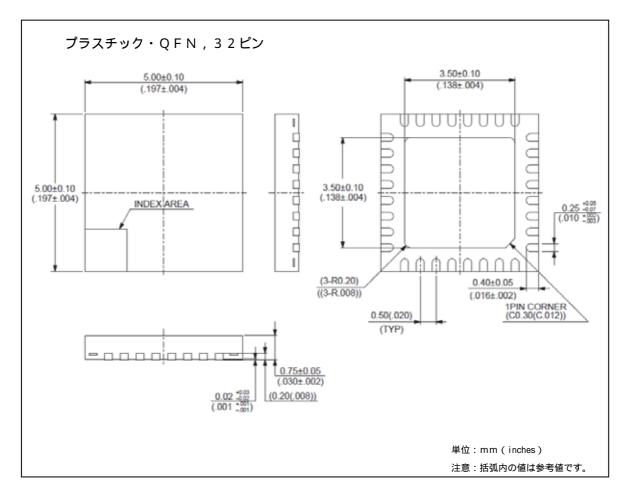
プラスチック・LQFP,32ピン	リードピッチ	0.80mm
	パッケージ幅× パッケージ長さ	7 × 7 mm
	リード形状	ガルウィング
	封止方法	プラスチックモールド
	取付け高さ	1 . 7 0 mmM A X



http://www.fdk.co.jp

[RPG100F]

プラスチック・QFN,32ピン	リードピッチ	0.50mm
	パッケージ幅× パッケージ長さ	5 × 5 mm
	封止方法	プラスチックモールド
	取付け高さ	0 . 8 0 mmM A X



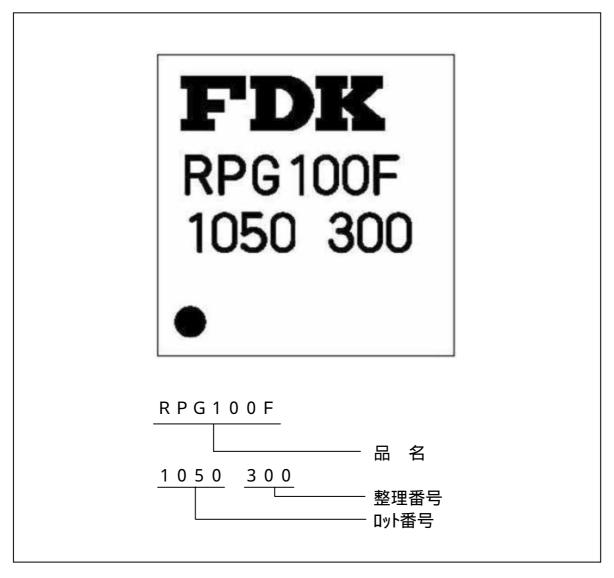
捺印

[RPG100]



http://www.fdk.co.jp

[RPG100F]



本資料の記載内容は、予告なしに変更することがありますので、御用命の際は営業担当部門に御確認ください。 本資料に記載された情報・図面の使用に起因する第三者の特許権、その他の権利侵害について、当社はその責を負いません。

http://www.fdk.co.jp

実装条件

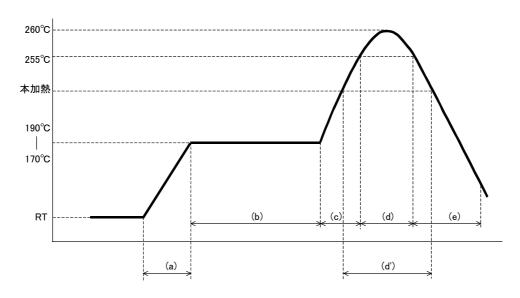
[RPG100 , RPG100F]

パッケージの実装に関しては、下記の方法を推奨致します。

[推奨実装条件]

項目	内 容		
実装方法	赤外線リフロー		
実装回数	2回		
保管期間	開梱前	製造後1年以内にご使用下さい。	
	開梱~2回目リフロー迄の保管期間	4日以内	
	開梱後の保管期間を超えた場合	ベーキング(125 24hrs)を実施の上、 4日以内に処理願います。	
保管条件	5~30、70%RH以下(出来るだけ低湿度)		

赤外線リフロープロファイル



(a) 温度上昇勾配:平均1~4 /sec

(b) 予備加熱 : 温度 170~190 、60~180sec

(c) 温度上昇勾配:平均1~4 /sec

(d) L°-7温度 : 温度 260 Max.、255 up 10sec 以内

(d') 本加熱 : 温度 230 up 40sec 以内 or

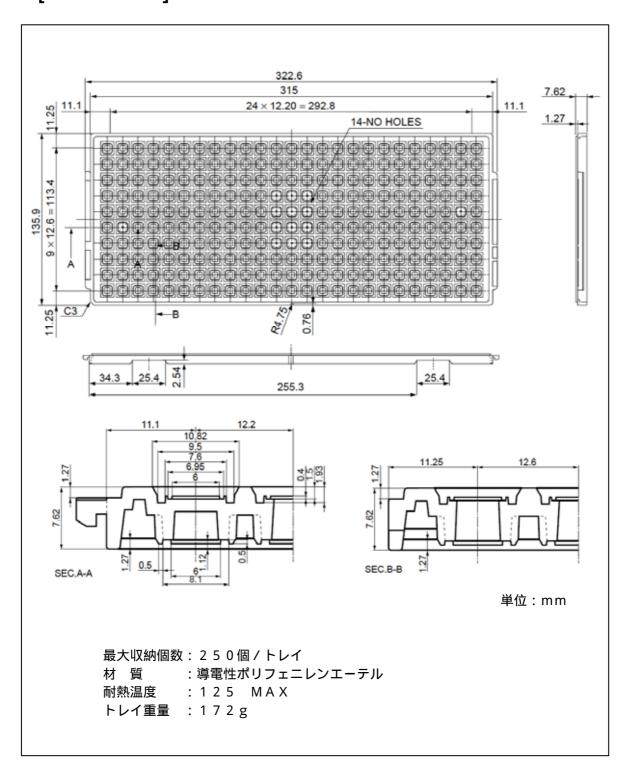
温度 225 up 60sec 以内 or 温度 220 up 80sec 以内

(e) 冷却 : 自然空冷または強制空冷

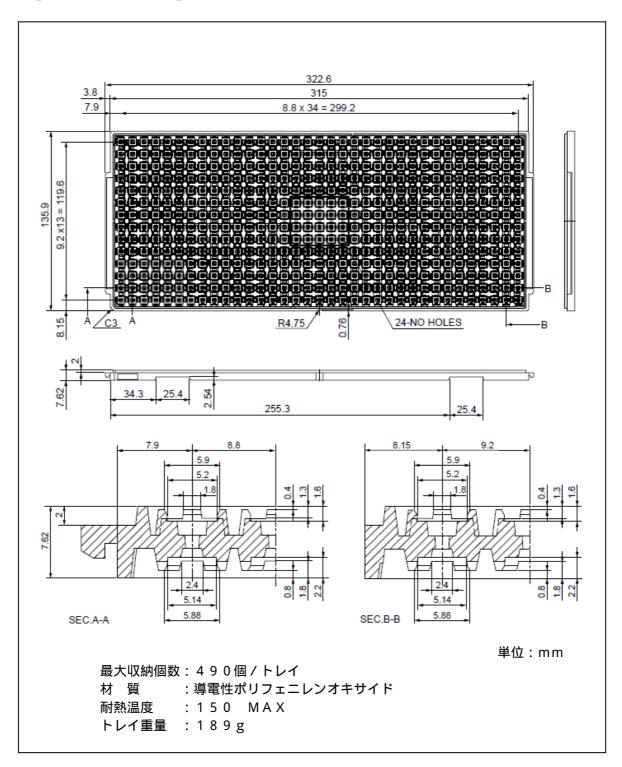
*パッケージボディー上面温度を記載

トレイ

[RPG100]



[RPG100F]



包 装

[RPG100, RPG100F]

